

合肥晶合集成电路股份有限公司

关于变更公司注册资本、修订《公司章程》及制定、修订部分内部治理制度草案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 30 日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》《关于就公司发行 H 股股票并上市修订及制定部分公司治理制度的议案》，前述事项已分别经公司 2023 年第二次临时股东大会、2025 年第一次临时股东会授权董事会办理，无须提交股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、变更注册资本的相关情况

公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成就。本次实际归属的限制性股票数量为 1,456,540 股，归属股票来源为公司向激励对象定向发行的人民币 A 股普通股股票。2025 年 11 月 19 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了上述限制性股票的股份登记手续。具体情况详见公司于 2025 年 11 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶合集成关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2025-072）。

本次限制性股票归属完成后，公司总股本由 2,006,135,157 股增加至 2,007,591,697 股，注册资本由 2,006,135,157 元增加至 2,007,591,697 元。

二、修订《公司章程》的具体情况

根据本次限制性股票归属登记情况，同时结合市场监督管理部门对公司经营范围中规范性表述的调整，公司对《公司章程》中的相关条款修订如下：

修订前	修订后
<p>第六条</p> <p>公司注册资本为人民币 200,613.5157 万元，总股数为 200,613.5157 万股，均为普通股股份。</p>	<p>第六条</p> <p>公司注册资本为人民币 200,759.1697 万元，总股数为 200,759.1697 万股，均为普通股股份。</p>
<p>第十四条</p> <p>公司的经营范围：集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p> <p>公司的经营范围以公司登记机关核定为准。</p>	<p>第十四条</p> <p>公司的经营范围：集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。</p> <p>公司的经营范围以公司登记机关核定为准。</p>

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。根据公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，本次变更注册资本及修订《公司章程》事项已授权董事会办理，无需提交股东会审议。

上述变更将最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

三、制定、修订公司 H 股发行并上市后适用的相关内部治理制度（草案）的情况

基于公司拟发行 H 股并上市需要，根据《中华人民共和国公司法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，并结合公司的实际情况，对公司于 H 股发行上市后适用的相关内部治理制度（草案）的相关内容进行制定、修订。具体情况如下：

序号	制度名称	变更情况	是否需要股东会审议
1	《关联（连）交易实施细则（草案）》	修订	否
2	《投资者关系管理制度（草案）》	修订	否
3	《利益冲突管理制度（草案）》	制定	否

根据公司 2025 年第一次临时股东会的授权，本次相关内部治理制度（草案）的修订无需提交股东会审议。上述制定、修订的内部治理制度草案自公司本次发行

的 H 股股票于香港联交所主板挂牌上市之日起生效并实施，在此之前，除另有修订外，现行的内部治理制度将继续有效。上述制度中《关联(连)交易实施细则(草案)》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

合肥晶合集成电路股份有限公司董事会

2025 年 12 月 31 日